



JA 0006468

JAN 1977

117

BEST AVAILABLE COPY

<p>LE3 M20 P15 R45 (M26)          METAL IND KK          A-002884 (15-01-77) 823k-35/26 C22c-13 H011-23/14          cut by diamond blade, for semiconductor use - contains tin,          copper and/or antimony</p>	<p>SUMMO 04.07.75          *JS 2006-466          L13-D5F1 M(23-A1).</p>
<p>alloy consists of 60 to 80 wt. % of Sn, 5 to 35 wt          3 to 13 wt. % of Cu and/or Sb. It is suitable          semiconductor pellet bonding. The solder layer          good absorber of thermal stress in a semicon-          ductor.</p>	<p>98</p>

J52006468

⊕

90.60~90.8、AG 5~3.5 であること、  
 である。

[illegible]

本委員の考へは、國債條の監理であるが、  
財政部の監理は、この一時的の監理であるの  
で、やはりやや暫く監理するの計を案出する  
ことを出来、パウ・スタンダム氏の監理におけ  
る約りのことに依する點に於いても片斷を述べ  
ず、この條の設置による半導の國家的な劣化  
の起るをそれもない。

またこのうちには、設備におけるマイクロボツ  
クス設備が、標準となる滞在時間／とちが決定  
して、この設備以上であり、速は〇秒／ミツの速さ

[illegible]

实验 9.2

[illegible]

この両者をダイヤモンドブレードでカットし、  
のチップに切断した。もうおぼろの硝子で硝子鏡  
筒では非常になめらかでなく、取替うの必要には  
常面を磨し、ダイヤモンドブレードの研削能力を  
うたにして、おぼろを研削し、ダイヤモンドチップで研削  
欠けたり割れたりしたものは捨てるが、

### 實施例 2

(5)

代理人 弗列士 申 利 德 史

**BEST AVAILABLE COPY**